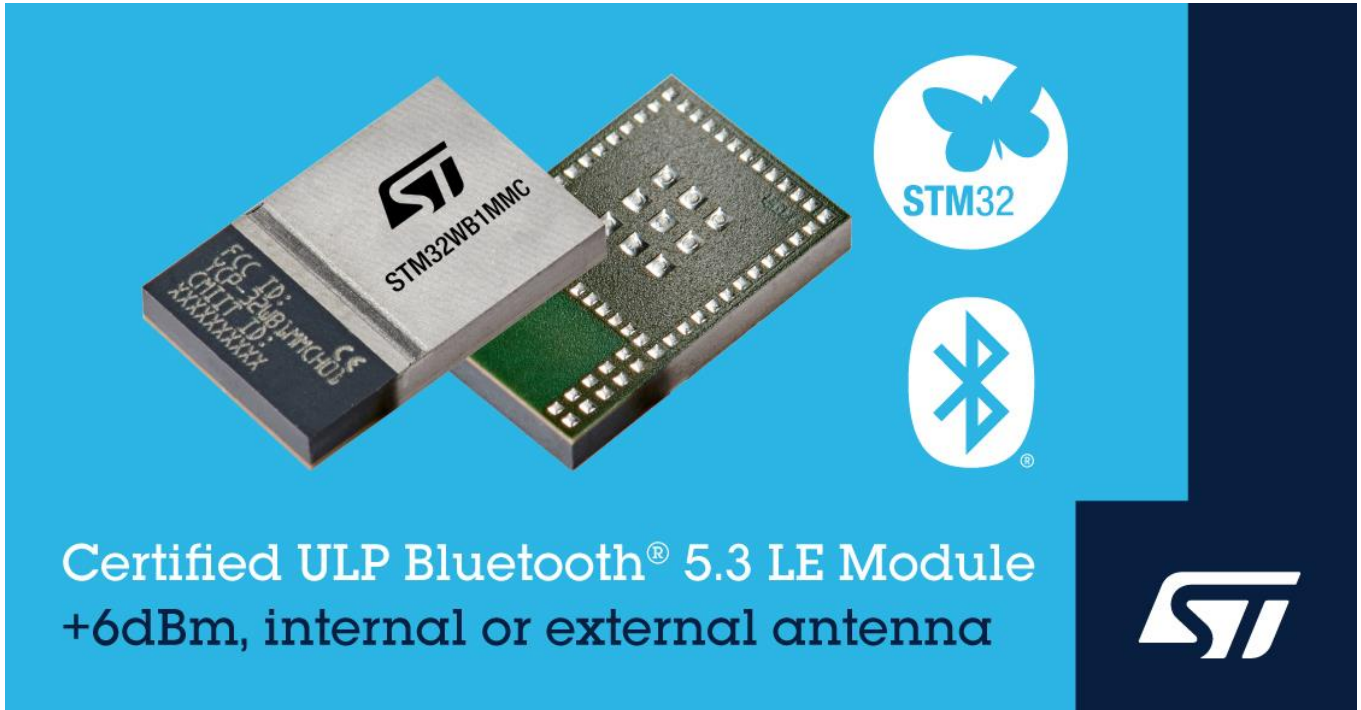




life.augmented

新聞稿



意法半導體推出 STM32WB1MMC Bluetooth® LE 認證模組 簡化並加速無線產品開發

【臺北訊，2023 年 3 月 29 日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM）新推出之 STM32 Bluetooth®無線模組讓設計人員能在無線產品，尤其是中低產量之專案中發揮 STM32WB 雙核微控制器 (MCU) 的優勢。

該模組取得 Bluetooth Low Energy 5.3 認證和全球無線電設備之許可，支援 STM32Cube 生態系統，有助於簡化應用開發，加速產品研發週期。

STM32WB1MMC 多合一模組緩解供應鏈緊繃之挑戰和交貨時間的難題，並有助於避免認證成本和縮短產品開發時間。STM32WB1MMC 採用 LGA 封裝且提供完整的參考設計，在一塊價格平易近人的 PCB 電路板上組裝無線產品所需的全部元件。模組上具備內建天線，以及為其天線優化的配對網路。如果不想使用內建天線，外部天線腳位連接外部天線非常方便。射頻輸出功率高達+6dBm，接收靈敏度-96dBm，結合優化的訊號路由，STM32WB1MMC 可以建立資料速率高達 2Mbit/s 之可靠的遠距離通訊。模組內部整合了開關式電源為子系統供電。整個模組均由 ST 製造，這種製造模式簡化供貨管理和客戶技術支援，意法半導體的 10 年滾動式產品壽命計畫確保該產品長期供應。

該模組採用 320KB 快閃記憶體和 48KB RAM 的 STM32WB15 MCU。Arm® Cortex®-M0+和 Cortex-M4 所組成的雙核架構確保 M0+射頻子系統和 M4 使用者均能獲得出色的即時性能。而 Bluetooth 5.3 協議堆疊和設定檔支援還最新的功能，包括廣播擴充。為最大限度地減少電能，該 MCU 亦提供靈活的電源管理模式，包括待機和停止 2 模式，延長自供電力裝置的續航時間，可達到長時間運行而無需人工介入的能力。該模組讓開發者能輕鬆使用 STM32WB15 的全部功能，包括 12 位元模位數組轉換器 (ADC)、各種數位介面，以及一個介面。

相似於整合更大快閃記憶體和 SRAM 的現有 STM32WB5MMG 模組，STM32WB1MMC 模組及其配套的 B-WB1M-WPAN1 評估板完全整合於 STM32Cube 環境中。因此，使用該模組開發軟體與使用任何一款 STM32WB MCU 開發軟體一樣便利。STM32CubeWB MCU 套裝軟體包括硬體抽象層 (HAL) 韌體、底層 API、檔案系統和 RTOS 系統。由於與其他 STM32WB MCU 共用套裝軟體，開發者可將現有專案直接移植到新模組，並最大限度地提升開發靈活性，以及加速專案完成進度。

STM32WB1MMC 模組現已量產。

更多資訊，請造訪：

<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wbxm-modules.html>。

**STM32 為意法半導體國際有限公司 (STMicroelectronics International NV) 或其相關公司在歐盟和 / 或其他地區之註冊和 / 或未註冊商標。STM32 亦已在美國專利商標局註冊。*

關於意法半導體

意法半導體擁有 48,000 名半導體技術的創造者和創新者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。身為一家半導體垂直整合製造商 (IDM)，意法半導體與逾二十萬家客戶、數千名合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同建立生態系統，協助利益關係人因應各種挑戰和新機會，滿足世界對永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電力和能源管理更高效，物聯網和互聯技術應用更廣泛。意法半導體承諾將於 2027 年實現碳中和。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：www.st.com。